

证券简称：四方达

证券代码：300179

河南四方达超硬材料股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告



二零二六年七月

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《河南四方达超硬材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次发行预计募集资金总额为不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 募集资金拟投入额 (万元) |
|----|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 金刚石钻针产业化项目 | 184,565.25 | 175,000.00 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | | 209,565.25 | 200,000.00 |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析

（一）金刚石钻针产业化项目

1、项目概况

金刚石钻针产业化项目将依托企业现有厂区开展厂房改造与配套公辅设施建设，购置高精度激光加工、精密磨削、全自动尺寸检测等专业生产及检测设备，配套部署仿真设计、仓储管理等专业软件系统，实现金刚石钻针的规模化量产。项目依托公司多年沉淀的聚晶金刚石复合材料、多轴激光精密加工、精密刀具设

计等核心技术储备，围绕高频高速电路板、碳化硅及单晶硅衬底等下游高端制造领域对高精度、长寿命微孔加工工具的刚性需求，完成金刚石钻针产品工艺落地与批量供货，增强国内高端半导体加工耗材本土供给能力。项目落地后将丰富公司精密超硬刀具产品矩阵，切入集成电路、半导体等应用领域，新增高附加值盈利板块，优化公司整体盈利结构，提升企业在超硬精密工具领域的市场竞争力与行业抗风险能力，支撑企业中长期高质量可持续发展。

2、项目的必要性和可行性

(1) 必要性

1) 匹配集成电路与半导体增量需求，强化本土企业高端基材加工能力

全球 AI 算力基础设施持续扩容，叠加半导体产业快速扩张，高频高速覆铜板、单晶硅、碳化硅等硬脆基材市场需求持续放量，这类材料硬度高、易崩裂，对微孔加工工具的精度、韧性、耐磨寿命提出严苛标准。本项目产品金刚石钻针适配前述场景带来的新需求，金刚石钻针材料具有高耐磨性、刚性高等特点，可适配高端基材加工，是具备高频属性的生产耗材。

国内高端金刚石钻针细分赛道面临快速发展的市场机遇，市场供需矛盾持续凸显。本项目旨在搭建完整自动化产线，提升公司规模化量产高性能钻针能力，加强本土科技制造业企业在高端基材方面的制造能力。募投项目建成后可承接集成电路、半导体企业持续释放的批量采购订单，匹配集成电路、半导体赛道长期稳定的增量需求。

2) 响应高端钻针进口替代需求，增强本土产业链供应能力

随着 PCB 产业和半导体产业的快速发展，当前国内高阶 PCB、半导体加工环节需求显著增长。海外品牌存在供货周期长、定价偏高、高端产品供给不足等制约因素，带给下游 PCB、单晶硅等加工企业耗材成本高、交付不稳定的供应链管理难题，超细径金刚石钻针产品的本土有效供给规模亟需增强。

公司依托二十余年超硬材料领域的技术积淀，已成功攻克高端金刚石钻针的材料难题。凭借自研的“耐磨-韧性协同增强”金刚石复合材料微结构成分调控技术，公司有效解决了耐磨与韧性无法兼顾的痛点。针对高频高速覆铜板高硬度、

多层级等特性，公司开发出金刚石钻针产品可实现高倍径长径比加工。预计项目建成后可年产 710 万支金刚石钻针，将有效完善精密加工工具的本土产业链配套能力。

3) 延伸公司超硬材料业务链条，增强公司盈利能力

公司现有主营业务集中于油气钻探、矿山开采、汽车零部件加工类超硬刀具，相关赛道市场发展成熟，为本项目储备了坚实的技术基础。金刚石钻针属于高科技行业的新兴需求，规模化投产后能够优化公司产品结构，提升盈利水平。公司自主掌握金刚石合成、多轴激光微加工核心技术，已组建专项研发团队，前期已完成多款钻针样品开发，具备产业化基础。

项目依托公司深耕多年的超硬材料研发、精密刀具制造技术储备拓展集成电路、半导体应用领域，扩充高端精密金刚石工具产品矩阵，形成区别于行业同行的差异化产品布局，构建面向集成电路、半导体产业的金刚石钻针量产能力，进一步强化企业核心竞争壁垒，开辟第二增长曲线，支撑企业中长期高质量发展。

(2) 可行性

1) 国家政策大力支持为项目实施提供了良好的政策环境

《产业结构调整指导目录（2024 年本）》明确：“硬质合金、超硬材料等切削刀具及工具系统，高性能磨料磨具（金刚石、CBN 等超硬材料及其微粉）”，属于“鼓励类”。其次，《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》工信部、市监总局《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》提出“持续支持集成电路领域科技创新，提升产业链供应链韧性和安全水平”，项目聚焦半导体加工耗材国产替代，符合专项行动支持方向。

《工业母机高质量标准体系建设方案》原文明确标准体系覆盖“超硬刀具、微刃刀具”，提出加快高端刀具标准研制、补齐工业母机配套工具短板，项目量产微米级金刚石钻针，契合标准体系建设重点方向。综上，良好的政策支持为项目的建设奠定了基础。

2) 企业技术储备与研发人才体系成熟，具备新产品规模化量产的完整支撑能力

公司长期深耕聚晶金刚石复合材料研发与精密超硬刀具制造，构建起覆盖材料研发、精密加工、成品检测全流程的自主技术体系，无需依赖外部技术授权，能够独立完成金刚石钻针的研发与量产落地。在核心材料技术层面，企业自主完成高耐磨高韧性金刚石复合材料开发，针对 PCB、单晶硅两类不同加工基材定制材料配方，解决行业内金刚石刀具耐磨性能与抗冲击韧性难以兼顾的技术痛点，相关材料制备工艺已形成技术闭环，同时配套自主研发的金刚石合成技术，从源头保障钻针刀头原材料稳定供给。精密加工工艺方面，企业掌握多轴数控激光加工工艺开发能力，可根据钻针超细径、超高长径比加工要求调整工艺路径，有效控制尺寸公差和加工质量。人才层面，公司组建专门面向金刚石材料与金刚石钻针方向的研发团队，团队汇聚材料、机械加工等多领域高技术人员，持续输出前沿材料与加工工艺成果；一线生产技工均具备多年超硬刀具加工实操经验，可快速适配钻针精细化生产工序。依托自有材料、加工、检测全套技术以及稳定的研发、生产人才梯队，企业不存在技术卡脖子、人员短缺等产业化障碍，能够稳定支撑金刚石钻针项目规模化生产实施。

3) 下游客户需求稳定，项目产能具备充足消化空间

全球 AI 算力基础设施持续扩容，叠加国内集成电路、半导体加工耗材国产替代长期红利，行业供需缺口持续扩大，行业成熟客户资源能够充分消化项目产出。需求端，高频高速覆铜板、单晶硅、碳化硅均属于高硬度易脆裂基材，金刚石钻针材料具有高耐磨性、刚性高等特点，可适配高端基材加工，是具备高频属性的生产耗材，可满足精密微孔加工的长期需求。随着产能顺利释放，市场消化可行性明确。

3、项目实施主体及实施地点

本项目的实施主体为四方达，实施地点为郑州市。

4、项目建设期

本项目建设周期为 36 个月。

5、项目投资概算

本项目预计总投资为 184,565.25 万元，其中建设投资 156,049.39 万元，铺底流动资金 28,515.86 万元，具体投资构成如下：

| 序号 | 项目 | 投资金额 (万元) | 投资金额占比 | 拟使用募集资金 (万元) |
|-----------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 建设投资 | 156,049.39 | 84.55% | 156,049.39 |
| 1.1 | 工程费用 | 143,695.70 | 77.86% | 143,695.70 |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 5,611.09 | 3.04% | 5,611.09 |
| 1.1.2 | 设备购置费 | 136,053.30 | 73.72% | 136,053.30 |
| 1.1.3 | 安装费用 | 2,031.31 | 1.10% | 2,031.31 |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 4,922.76 | 2.67% | 4,922.76 |
| 1.3 | 基本预备费 | 7,430.92 | 4.03% | 7,430.92 |
| 2 | 铺底流动资金 | 28,515.86 | 15.45% | 18,950.61 |
| 合计 | | 184,565.25 | 100.00% | 175,000.00 |

6、项目效益分析

本项目所得税后内部收益率（IRR）为 17.66%，该项目投资效益良好。

7、项目涉及报批事项

截至本预案披露日，本项目所涉及备案正在办理中，相关程序的办理不存在实质性障碍。

（二）补充流动资金项目

1、项目概况

为满足公司业务发展对流动资金的需求、优化资本结构，本次向特定对象发行股票所募集资金中 25,000.00 万元用于补充流动资金。

2、项目的必要性和可行性

（1）必要性

本次募集资金投资项目建成投产后，公司业务进一步扩充，生产经营所需的营运资金投入相应增加；同时，为持续保持技术领先优势，公司在产品开发等方面的研发投入亦将持续加大，对公司整体资金实力与资金储备提出更高要求。因此，通过本次发行补充流动资金，可有效满足公司在技术研发、人才引进及市场

渠道拓展等方面的资金需求，有利于进一步增强产品综合竞争力，夯实业务扩张基础，为公司长期稳健发展提供坚实资金支撑与保障，具备必要性。

(2) 可行性

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金符合公司未来业务发展需要，有利于公司持续提升经济效益，实现公司发展战略，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等关于募集资金运用的相关规定。公司已经建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和内部控制环境，并制定了专项管理制度，对募集资金的存储、使用、变更与监督等进行明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储及使用，依据《上市公司募集资金监管规则》《股票上市规则》等法律法规的相关要求，保证募集资金合理规范使用。

三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 对公司经营管理的影响

本次发行的募投项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金运用方案合理、可行。

项目顺利实施后，公司整体技术实力将进一步提高，业务优势将进一步凸显，提高公司未来整体盈利水平。本次发行符合公司长期发展需求及全体股东的利益。

(二) 对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均将有所增长，营运资金将得到进一步充实。本次向特定对象发行有利于增强公司的抗风险能力及经营稳健性，为公司和股东带来更好的长期回报。

四、本次向特定对象发行的可行性结论

本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，

增强公司后续融资能力和可持续发展能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2026年7月1日